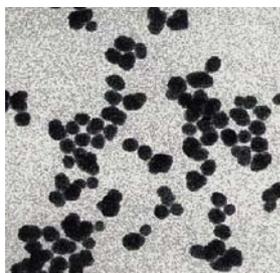
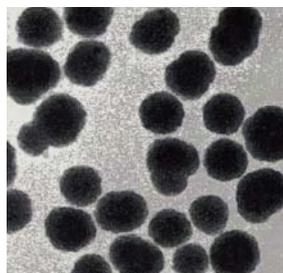


PLANERLITE

CMP



PLANERLITE-7101



PLANERLITE-4101



この写真はイメージです。This photograph is an image.

■PLANERLITE

PLANERLITEシリーズは、高密度化するULSIデバイスの平坦工程に取り入れられたCMP(CHEMICAL MECHANICAL PLANERLIZATION)技術に使用されるポリシング材で、高純度、高加工能率、高分散、スクラッチフリーを基本コンセプトに開発された製品です。

・PLANERLITE-4000シリーズ

SiO₂膜(層間絶縁膜、STI)を対象とするポリシング材です。

超高純度コロイダルシリカ及びフュームドシリカをベース材料とするタイプで構成され、添加剤・砥粒濃度別に各種グレードがあり、プロセスコンディションとコストパフォーマンスに最も適合する製品をお選び頂くことが可能です。

・PLANERLITE-6000シリーズ

Poly-Siを対象とするポリシング材です。

特殊添加剤を配合した超高純度コロイダルシリカベースの各種研磨用タイプと研磨後のウェハ面を親水化処理するリンス剤で構成されています。

研磨用スラリーはどの製品もPoly-Siの加工能率が非常に高く、かつシリコン酸化膜に対する高い選択性も有しております。

リンス剤は、パーティクルの付着を防止し、洗浄を容易にする作用があります。

このシリーズは、いずれも高希釈使用が可能であり、希釈率の調整により、加工能率及び選択比の最適化を容易にするとともに、コストパフォーマンスに優れた面も持ち合わせております。

また、完全分散した砥粒を使用しているため、全く沈澱を起さない極めて安定したスラリーです。

■PLANERLITE

The PLANERLITE series of polishing slurries is intended for use in chemical mechanical planerlization (CMP), a key planerization process in the fabrication of high-density ULSI devices. It has been developed under the basic concepts of high purity, high removal rate, high dispersion and scratchfree performance.

PLANERLITE-4000 series

This polishing slurry is designed for use on SiO₂ films (interlayer dielectric, STI). Based on ultra-high purity colloidal silica or fumed silica, it is available in several grades with varying additives and abrasive particle concentration, enabling users to select the product optimal for their specific process parameters and cost/performance requirements.

PLANERLITE-6000 series

This polishing slurry is designed for use with polysilicon. There is a variety of types available, either polishing slurry based on ultra-high purity colloidal silica or rinsing agent with special additives which keeps post-polishing wafer surface hydrophilic. The polishing slurry, in all types has extremely high polysilicon removal rate with excellent selectivity to silicon oxide film. The rinsing agent helps prevent particle adhesion, simplifying wafer cleaning process. The entire line can be used at high dilutions, and adjustment of the dilution provides control of removal rate and selectivity while also delivering high cost/performance. Abrasive particles are completely dispersed, eliminating sedimentation in a high stable slurry.

■PLANERLITE

・PLANERLITE-7000シリーズ

ダマシン工程に使用される銅配線を対象とするポリシング材です。

特殊添加剤を配合した超高純度コロイダルシリカをベースとしており、銅に対し高い加工能率とバリアメタルに対する高い選択性を有しております。従ってエロージョンも少なく、バリアメタル上の銅残りも少ないため、わずかなオーバーポリシングで銅膜を完璧にクリアすることが出来ます。

また、スクラッチも少なく、沈殿も起さない極めて安定したスラリーです。

高希釈タイプも取り揃えており、ダマシンプロセスのコストダウンに貢献します。

・PLANERLITE-8000シリーズ

銅配線で使用するバリアメタルを対象とするポリシング材です。特殊添加剤を配合した超高純度コロイダルシリカをベースとしており、バリアメタルに対する加工に加えて、加工後の平坦化を維持する為に必要な選択比を有しております。

また、配線形成に対して有害な研磨面の面荒れ、スクラッチ及び腐食の発生も無く、銅配線形成に対して理想的なスラリーです。

※この他にもご要望に応じて各種試作品をご用意致します。

■PLANERLITE

PLANERLITE-7000 series

This polishing slurry is designed specifically for Cu metallization in the damascene process. Based on ultra high purity colloidal silica with special additives, it delivers high copper removal rate, with excellent selectivity to barrier metal. As a result, erosion is low and residual copper on the barrier metal is minimal, making it possible to completely stable, with no sedimentation, and minimal scratching. We also offer a high-dilution type, contributing to lower cost for copper damascene process.

PLANERLITE-8000 series

This polishing slurry is designed for barrier metal in the Cu interconnection. Based on ultra purity colloidal silica with special additives, it delivers enough barrier metal removal rate with planarity to be kept by designed selectivity. Also it delivers minimal scratch and minimal roughness, as ideal polishing slurry.